

2018年度事業計画

実装部品包装標準化専門委員会

委員会の役員	委員長：京セラ 副委員長：太陽誘電 パナソニックスマートファクトリーソリューションズ パナソニックセミコンダクタソリューションズ/半導体包装SC 主査 幹事：村田製作所, 信越ポリマー 監事：ゴールド工業
委員会の構成	15社30名(内 客員・オブザーバ 3名)
委員会の会費	90,000円×15社
会議開催の予定	第93回 4月20日(金曜日) 第94回 6月29日(金曜日) 第95回 9月14日(金曜日) 第96回 12月21日(金曜日) 第97回 2月22日(金曜日)
事業計画の概要	<新規事項> 1. JEITA 規格の制定・改正・確認・廃止 なし 2. JIS 草案作成 ・ JIS C 0806-1 アキシャルテーピング改正 (平成30年度公募 対応規格：IEC60286-1) ・ JIS C 0806-2 ラジアルテーピング 改正 (平成29年度公募 対応規格：IEC60286-2) ・ JIS C 0806-301 表面実装部品静電気電位及び静電気漏洩試験方法 改正 (平成30年度公募 対応規格：JEITA ET-7104 規格群) 3. IEC 規格等 なし <継続事項> 1. JEITA 規格の制定・改正・確認・廃止 ・ 確認、廃止の検討継続 ・ ET-7104-2 発行 2. IEC 規格審議 1) IEC 60286-3 (SMD テーピング) FDIS、IS 発行 2) IEC 60286-5 (マトリックストレイ) FDIS、IS 発行 3. 各WG及びPG活動 1) 静電気活動 1-1) ET-7104 制定に関する検討WG ET-7104-2 発行 1-2) JWG13 対応 JWG13 の活動を通し、TC101 と連携し、実のある TR 発行に繋げる。 2) オートローディングフィーダ対応検討PG 実装機メーカー ⇄ 部品メーカー間の意見を調整し、オートローディングフィーダに 適した容器包装仕様に関するガイドラインを策定する。 3) IEC 規格と EIA 規格との整合化調査対応PG EIA から依頼が有った検討提案を基軸に、を継続する。 4) バルク関係 情報収集及び発信 実装部品包装標準化専門委員会で状況確認を継続。 市場及び海外の動きを確認する。 4. IEC 国際会議対応 TC40/WG36 釜山会議へ参画。 2018年10月16～19日開催予定。 日本が Convenor を担当する IEC 規格の改正進捗、静電気 (JWG13、JEITA 規格)、

	<p>オートローディングフィーダ、IEC規格とEIA規格との整合化調査に関する取組み等の報告。</p> <p>5. 講演会・勉強会の実施 JEITA標準化委員会との共催報告会。 2018年12月開催予定。</p> <p><その他・他委員会との連携・協力></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IEC TC40 国内委員会 2. JEITA実装技術標準化専門委員会/TC91 国内委員会 3. JEITA半導体包装サブコミティ 4. RCJ IEC TC101 国内委員会 5. TC101/TC40 JWG13
--	--

事務局	(社) 電子情報技術産業協会 標準化センター
-----	------------------------